



kingston.com/epop

ePoP

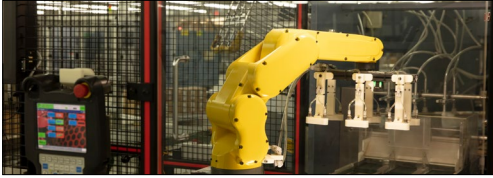
ePoP – Embedded Package-on-Package memory per dispositivi indossabili

Kingston ePoP offre un componente standard JEDEC altamente integrato che combina lo storage su supporti Embedded MultiMedia Card (eMMC) con le DRAM LPDDR (Low-Power Double Data Rate) in una singola soluzione PoP (Package-on-Package). I dispositivi ePoP sono installati direttamente in cima a un SoC (System-on-a-Chip) host compatibile, che riduce lo spazio richiesto sul PCB (Printed Circuit Board), garantendo prestazioni ottimali. Le soluzioni ePoP sono ideali per le applicazioni che richiedono spazi limitati, come quelle associate ai dispositivi indossabili.

PRINCIPALI VANTAGGI

- L'installazione diretta a monte di un SoC host, fa degli ePoP soluzioni ideali per le applicazioni di formato compatto, come gli indossabili.
- Le DRAM a basso consumo e il firmware storage ottimizzato riduce i consumi energetici, offrendo al contempo tutte le prestazioni necessarie per le applicazioni degli indossabili alimentati da batterie.
- Tale approccio consente anche di semplificare il design del sistema, riduce il time to market e abbrevia i tempi di certificazione.
- Sono disponibili molteplici configurazioni firmware, per adattarsi ai requisiti delle applicazioni in termini di prestazioni, potenza e durata del ciclo di vita.

FASCE DI MERCATO



IoT



Indossabili

Dispositivi per Realtà aumentata (AR) /
Realtà virtuale (VR)

NUMERI DI PARTE E SPECIFICHE EPOP

ePoP basate su LPDDR3

Numero di parte	Capacità		Standard		Pacchetto	FBGA	Temperatura di funzionamento
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EP04-N3GM627	4	4	5,0	LPDDR3	10x10x0,8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5,0	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C

ePoP basate su LPDDR4x

Numero di parte	Capacità		Standard		Pacchetto	FBGA	Temperatura di funzionamento
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
08EP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C

*Modalità pSLC, per una maggiore durata.